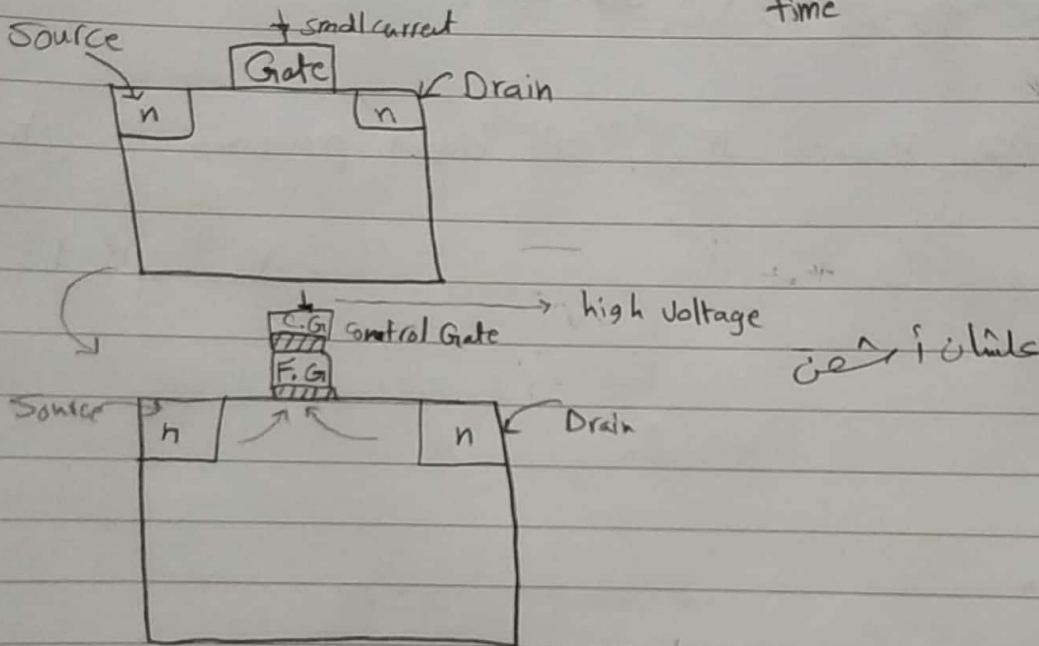


* F.G MosFET:

Access time Flash driver high power

Access time بتا حالي على كده



one's ROM بتكون عليها Erasing State

عشان اقلب على الجزء العازل الاول بجل Apply high voltage فيجب الشحنات من كذا (Drain)

وال F.G تكون فيها الشحنات المسحوبة و ال Drain عالي وده ال Erase State
وعشان كده بياخد وقت في ال Access

1744

1

Logical

Add.
Virtual of
Add.

	A9	A8	A0
RAM	0	x	x
Flash	1	x	x

Normal Case

Access time $\rightarrow t_A$

After MMU

$$\text{Access time} = t_A + \text{MMU delay} + \text{Page switching time}$$

neglected if Access happens
in the same page
several times

Flash $\rightarrow 1\text{KB}$
wz8

Page switching time

near $\rightarrow 256$ Far $\rightarrow 256 \quad 256 \quad 256$

System

Processor

(Add 10 bit)
(Data 8 bit) $\rightarrow 1024$

Flash

$\rightarrow 2\text{KB}$ wz8
Near $\rightarrow 512$
Far $\rightarrow 1.5\text{K}$ $\rightarrow 6$ Pages

SRAM

$\rightarrow 1\text{KB}$ wz8
Near $\rightarrow 256$
Far $\rightarrow 0.75\text{K}$ $\rightarrow 3$ Pages

How to cal the ^{no. of} output in MMU?

Ans. I have 9 Pages

So I have $9 \times 256 = 2.25\text{KB}$

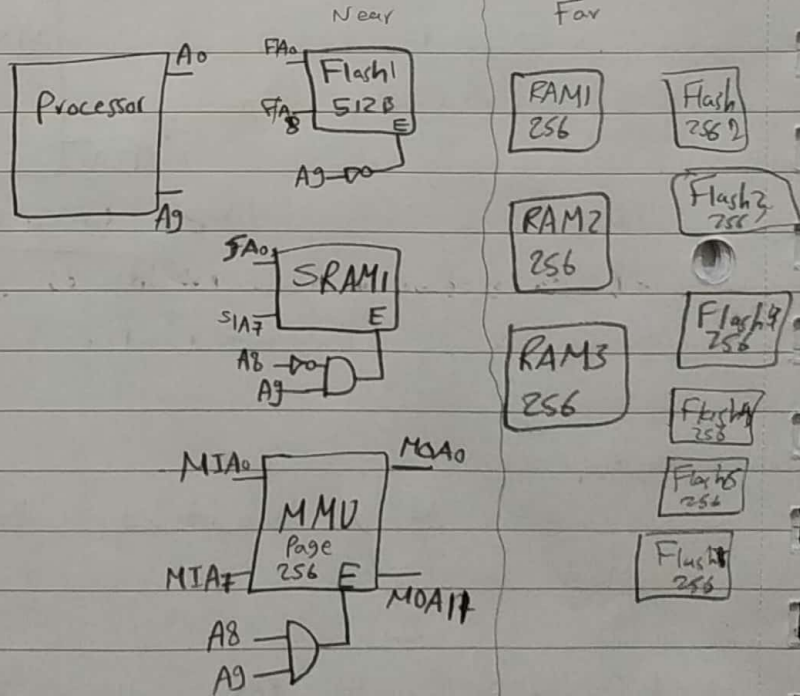
10 bit $\rightarrow 1024$

11 bit $\rightarrow 2048$

12 bit $\rightarrow 4096$ ✓

\rightarrow page 16 not used

Page Size $\rightarrow 256$



Page 7 = 16-9 not used

ملاحظة: اسم ال Page size يكون من ملاحظات ال 2

	MOA ₁₁	MOA ₁₀	MOA ₉	MOA ₈	MOA ₇	MOA ₀
Flash 1	0	0	0	0	x	x
Flash 2	0	0	0	1	x	x
Flash 3	0	0	1	0	x	x
Flash 4	0	0	1	1	x	x
Flash 5						

Page Register

111 1111 1111

مرحلة ① - أول حاجة بيكتب ال Page Bus على ال Add Bus.
أقول أنا هغير ال Page و يكون
باعت على ال Data Bus رقم ال Page

مرحلة ② - ثاني حاجة بيكتب ال Address بتاع ال Loc.
جوه ال Page و بيكتب على ال Data Bus

هذه علشان كده مش بغيري أكتب في آخر مكان في كل
Page لانه 1111 1111 1111 دائما بيبي index
أنا مايز أغير ال Page.

Example

to select MMU

① Add: 11 1111 1111 عايز أغير ال Page
data: 0000 0100 رقم ال Page
ال Page Register

to select MMU

② Add: 11 0000 1111

data: الرقم اللي هكون
عايز أكتبه

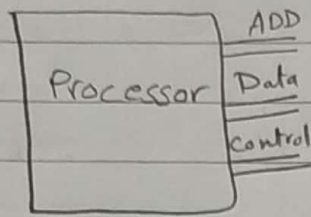
Von-Neumann

(The Father of Digital Design)

VS

Harvard Architecture

Von-Neumann



Pros

- Simple in design
- Cheap

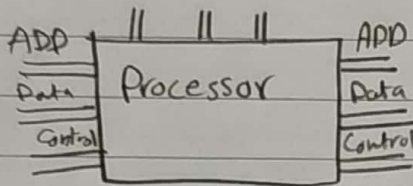
Cons

- Slower

Harvard

I/O

Flash



RAM

Pros

- Complex in design
- Expensive

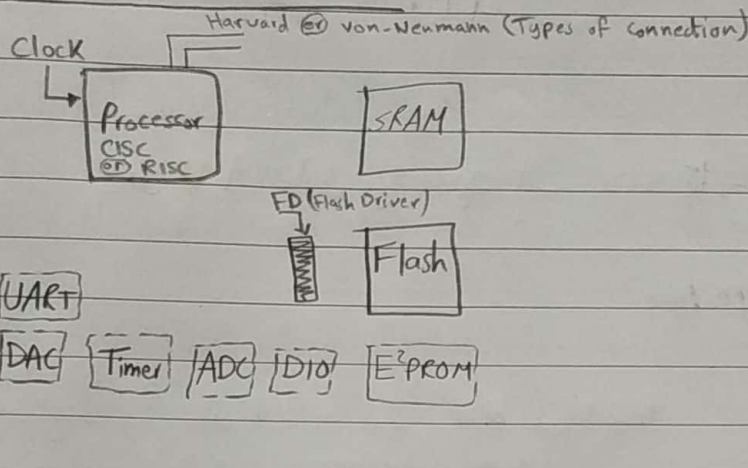
Cons

- Faster
- Pipeline is capable.

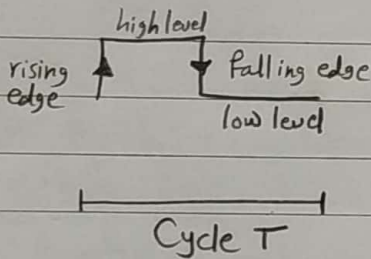
Assignment

Q. Von-Neumann و Harvard و RISC و CISC کی آپارٹیشن کیجیے

MC



Clock



Periodic time T

$$Freq = \frac{1}{T} \text{ Hz}$$

MIPS (Million Instruction Per Second)

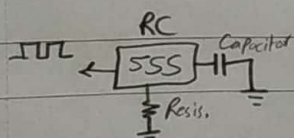
Freq یعنی اسی کامرے کے الائیہ
Hz یعنی کامرے کے الائیہ

Pipelining ← اس MIPS آکبر من عدد ال
Mega hertz

Clock System

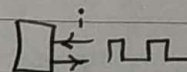
EMI → Electric magnetic field

Electrical



Mechanical

Low level Voltage و high level Voltage (oscillate) بین ال
- مادہ لپسے بناؤد کم یا فستھی



RC

Crystal oscillator

Ceramic oscillator

Accuracy	↓	↑	~
Cost	↓	↑	~
settling time	↑	↓	~
Noise immunity	↓	↑	↓
temperature	↓	↑	↓
EMI	↓	↑	↓
vibration	↓	↑	↓

ATmega 32

- n-bit Microcontroller

↳ n-bit act. size of operand & ALU (يعني)

- Advanced RISC Architecture

- Fully static operation

Transistor Based - 2ns to loads (يعني) (Refreshing circuitry required)

- 16 MIPS

16MHz is 16MIPS (يعني)

- On-chip 2-cycle Multiplier

2 cycle delay Multiplier (يعني)

- 32 Kbytes of In-system Self-Programmable flash

Flash size (يعني)
Driver
dog

2 Assignments

All datasheet.com

1) CISC or RISC

2) # of instruction

3) Longest time instruction

4) Flash??

5) SRAM or DRAM?

6) EEPROM?

→ PIC 16F877A

→ PIC 18F4550

→ STM32F103C8T6

ARM Based

↓
Processor 32 bit

Companies

① **Analyst** يفصل يكون مشهون

RFQ: Request for Quotation

①

CRS: على RQ مش مكتوب بشكل مفصل

② Customer require specification

System Engineer

مهندس النظام كوقت وير وطار ووير

③ SRS: Software Requirement specification وهو أغلب الكود

HSI: Hardware Software Interface

level in Egypt

Architect

← رتبة الـ software الكبير milestones

* Static Architecture

define every modules and their function then their arguments and returns.

③

* Dynamic Architecture

RAM consumption

ROM consumption

execution time (Kam cycle 3lashan tetnafez)

GDD "HLD"

GDD: Global Design Document

HLD: High Level Design

④

Designer

CDD: Component Design Document

UML: Unified Modeling Language

⑤

Developer

code

Tester

⑥ unit testing

⑦ Module testing

⑧ integration testing

Validator

⑨ Validation testing

Development

File.c

"Source File"



"executable File"

File.hex

.elf

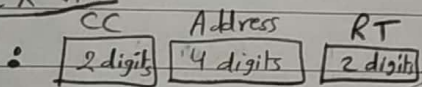
Burner

.exe

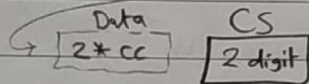
→ Flash

.Coff

HEX File



كل رقم في السطر هو Record أو Rec و يبدأ بـ 0



CC: Character count

مكتوب فيها عدد الـ Bytes

Bytes
يعني عن عدد الـ Bytes

RT: Record type

00 Data

01 EOF "End of File"

CS: check Sum

طريقة حسابها هي ان الطاعة الترتيب مع

مجموع كل الـ Bytes في كل سطر و بعد كده ايجب الـ 2's Complement و يكون جيب الـ check sum للسطر ده.

أخذ الـ Least Significant Byte

الـ tool و الـ Burner بمسبوها بنفس الطريقة

الـ Burner بيتاين الـ check sum ولو فيه فرق هيدي error

instruction by 2

→ Address

→ op code

→ operands

ins. → 16 bits
2 bytes

8B BA

2D1 → Out 11, R20
Op code

1000
1001
11 1010 A
00 1011 B

R20 1111 15
1010000 16
0001 17
0010 18
0011 19
0001 0100 20

-Instruction set

- 1) xx xx
- 2) construct op code
- 3) write new ins.

high Low
1011 1001 0100 1011
B 9 4 B

1011 1001 0100 1011
op code operand 2
⊕
operand 1

94 OC, Hex
1001 0100 0000 1100 Bin

1011 1001 0100 1011 Bin
OUT
00 1011
11
20

OUT 11, R20

Assembly